ACCRETECH

Wafer Edge Grinding Machine

W-GM-5200-SCX



- ベストセラー機W-GMシリーズ
- コンパクトな設計でスペース効率アップ
- X軸・Y軸・Z軸・θ軸の同期補完制御による高精度な研削
- タッチパネルによる簡単操作
- 脆性材料に特化した高剛性・高トルク研削機構

株式会社東京精密

W-GM-5200-SCX 仕様

基本仕様

ウェーハサイズ	Φ 300 mm
ウェーハの厚さ	0.6 ～ 1.0 mm
ウェーハ形状	Φ 300 mm（ノッチ付き）
外周研削	
砥石外径 溝部	Φ 200 mm
砥石外径 外周	Φ 202 mm
砥石内径	Φ 30 mm
砥石フランジ厚	20 mm
スピンドル回転数	4000 rpm
スピンドル軸受け方式	グリース潤滑・メカニカル軸受け方式
スピンドル機構	高トルク研削機構
研削スピード	任意設定可能
ノッチ研削	
砥石外径 溝部	Φ 1.8 ～ 2.4 mm
砥石外径 外周	Φ 3.8 mm
砥石シャンク径	Φ 3 mm
スピンドル回転数	40000 rpm
スピンドル軸受け方式	グリース潤滑・メカニカル軸受け方式
スピンドル駆動方式	モーター直結式
シグナルタワー	3色表示灯 （色・点滅・点灯はキー入力で変更可）

機構部仕様

ウェーハ厚さ測定	
分解能	1 µm
繰り返し測定精度	± 2 µm 以内
測定方法	非接触方式
アライメント機構	
方式	光学方式
分解能	1 µm
センタリング精度	35µm 以内
研削テーブル直線軸（X/Y/Z）	
分解能	1 µm
駆動方式	AC サーボモータとボールネジ
研削テーブル回転軸（θ）	
分解能	0.001°
研削テーブル平面度	
面振れ	10 µm 以下／ 360°
トランスファー部	
搬送方式	吸着搬送
真空発生源	真空エジェクタ
ウェーハ確認センサ	真空センサ
洗浄部	
洗浄方式	スピンナ洗浄
乾燥方式	ドライエア乾燥
駆動方式	AC サーボモータ
回転数	500 ～ 1500 min^{-1}
供給部・収納部	
方式	カセットキャリア方式 （オプションあり）

諸元

装置の寸法・重量	
W-GM-5200-SCX	3040 (W) x 1855 (D) x 2000 (H) / *2255mm 5000 kg　* 表示灯高さ

株式会社東京精密
（本社）〒192-8515 東京都八王子市石川町 2968-2
TEL：(042)642-1701 FAX：(042)642-1798
https://www.accretech.com
お問い合わせ先

●掲載内容は発行時点の情報に基づきます。
●仕様などの記載事項は製品改良のためお断りなしに変更することがあります。